

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015 年 12 月 17 日(17.12.2015)

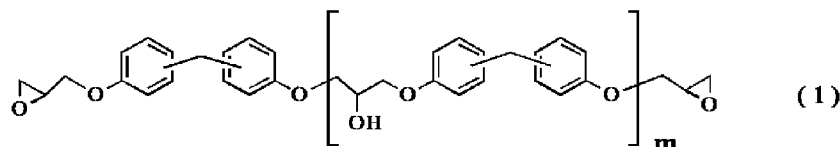


(10) 国際公開番号
WO 2015/190476 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/038 (2006.01) G03F 7/004 (2006.01)
C08G 59/62 (2006.01) G03F 7/075 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/066592
- (22) 国際出願日: 2015 年 6 月 9 日(09.06.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-122335 2014 年 6 月 13 日(13.06.2014) JP
- (71) 出願人: 日本化薬株式会社(NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 今泉 尚子(IMAIZUMI Naoko); 〒1158588 東京都北区志茂 3-3-1-12 日本化薬株式会社 機能化学品研究所内 Tokyo (JP). 小野 禎之(ONO Yoshiyuki); 〒1158588 東京都北区志茂 3-3-1-12 日本化薬株式会社 機能化学品研究所内 Tokyo (JP). 小泉 孝徳(KOIZUMI Takanori); 〒1158588 東京都北区志茂 3-3-1-12 日本化薬株式会社 機能化学品研究所内 Tokyo (JP). 熊谷 真希(KUMAGAI Maki); 〒1158588 東京都北区志茂 3-3-1-12 日本化薬株式会社 機能化学品研究所内 Tokyo (JP). 稲垣 真也(INAGAKI Shinya); 〒1158588 東京都北区志茂 3-3-1-12 日本化薬株式会社 機能化学品研究所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人浅村特許事務所(ASAMURA PATENT OFFICE, P.C.); 〒1408776 東京都品川区東品川 2 丁目 2 番 2 号 天王洲セントラルタワー Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, RESIST LAMINATE, CURED PRODUCT OF PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, AND CURED PRODUCT OF RESIST LAMINATE (11)

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物、レジスト積層体及びそれらの硬化物 (11)



(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide: a resin composition, a cured product of which has extremely low residual stress and exhibits excellent adhesion to a metal substrate such as a Pt, LT or Ta substrate after a wet heat test in the fields of semiconductors and MEMS/micromachine applications; a laminate of this resin composition; and a cured product of this resin composition or the laminate. The present invention is a photosensitive resin composition which contains (A) an epoxy resin, (B) a compound having a phenolic hydroxyl group and (C) a cationic photopolymerization initiator, and wherein: the epoxy resin (A) has a weighted average epoxy equivalent weight of 300 g/eq. or more; 20% by mass or more of the epoxy resin (A) is an epoxy resin represented by formula (1) and having an epoxy equivalent weight of 500-4,500 g/eq.; and the compound (B) having a phenolic hydroxyl group contains a phenolic compound having a specific structure.

(57) 要約: 本発明は、半導体やMEMS・マイクロマシンアプリケーション分野において、硬化物の残留応力が極めて低く、湿熱試験後のPt、LT及びTa等の金属基板との密着性に優れた樹脂組成物及び／又はその積層体、並びにその硬化物を提供することを目的とする。本発明は、(A) エポキシ樹脂、(B) フェノール性水酸基を有する化合物及び(C) 光カチオン重合開始剤を含有する感光性樹脂組成物であって、(A) エポキシ樹脂の加重平均エポキシ当量が300 g/eq. 以上であり、且つ、該(A) エポキシ樹脂の20質量%以上が、下記式(1)で表され、かつエポキシ当量が500~4500 g/eq. であるエポキシ樹脂であり、該(B) フェノール性水酸基を有する化合物が、特定構造のフェノール化合物を含有する感光性樹脂組成物である。

WO 2015/190476 A1